

2012年1月10日

お得意様へ

セメダイン株式会社

展示会「ネプコンジャパン2012」出展のご案内

拝啓、

皆様におかれましては日頃セメダイン製品ご愛用いただきまして誠にありがとうございます。弊社も来たる創業90周年を目指し、創業精神である新製品開発に日夜邁進しております。

さて、この度、首記展示会に当社としては初出展いたします。現在開発中の新製品なども多数参考出品いたしますので、ご多忙中とは存じますが是非弊社ブースにお立ち寄りください。

<記>

1. 展示会名

ネプコンジャパン内「第3回先端電子材料 EXPO (マテリアルジャパン)」

2. 会期

2012年1月18日(水)～20日(金)の3日間

3. 会場

東京ビックサイト

4. 出展内容(詳細はネプコンジャパン HP のe-ガイドブックご参照ください)

1) 機能性弾性接着剤シリーズ

各種セメダインスーパーXのご紹介

① 粘接着多用途形 ② 速硬化形 ③ 難燃形 ④ 放熱形 ⑤ 導電形

2) 難接着材料対応セメダインシリーズ

難接着材料といわれているPE、PP、シリコーン、ポリアセタール、フッ素樹脂などに適用できるセメダインと繊細な接着条件が要求される各種エンブラ、ポリカ、炭素繊維などに最適な各種セメダインを紹介いたします。

3) 開発提案品セメダイン新弾性シリーズ(参考出品:発売期日未定品)

① ノンプライマーでPPにつく弾性接着剤

② テープのように剥がせ、何度でも貼れる弾性粘着剤

③ UVで即粘着発現、その後湿気で弾性硬化する理想の粘・接着剤

④ 不透明材料もUVで即弾性接着、スクリーン塗布も可能な弾性接着剤

以上

ブースでお待ちしております、お気軽にお越しください。